

中关村产业技术联盟

信息简报

第 11 期

2026 年 8 月 3 日

中关村产业技术联盟联合会

COUNCIL OF INDUSTRY AND TECHNOLOGY ALLIANCES IN Z-PARK

【护航行动】	1
【时事热点】	3
正式启动！人形机器人与具身智能实景实训专项行动	3
【行业发展】	4
落地亦庄！北京首家词元（Token）工厂正式投用	4
国产 3D DRAM 新突破！微电子所实现 4 层堆叠 IGZO 存储	4
北京 RISC-V 数字基础设施创新中心揭牌成立	4
政校协同育工匠！共建亦城产业工人实训中心	5
【企业动态】	6
企业近期融资情况	6
全国首款龙架构农业专用 SoC “农芯一号” 流片成功	8
经开区国科天迅自研芯片护航火箭箭载通信	8
首款 3D 混合堆叠大模型专用处理器落地	9

【护航行动】

6月8日—6月21日，中关村产业技术联盟联合会、中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟在应用护航、资本护航方面继续开放资源，免费对示范区企业开放4场专场活动。

活动一：由中关村产业技术联盟联合会主办的京津冀科创产业融合科技成果转化研讨会

6月9日，京津冀科创产业融合科技成果转化研讨会在天津举办。活动由中关村产业技术联盟联合会等单位联合主办，在天津科技主管部门支持下开展，60余名京津科创、产业代表参会。参会人员实地参观海河实验室、天开高教科创园，观摩新材料、生物医药等前沿科研成果。京津科技部门负责人围绕区域科创一体化致辞，园区、孵化器及北航专家分别分享成果产业化路径，剖析转化堵点，探讨以产业需求反向驱动技术落地的方案。本次活动深化三地科创交流协同。

活动二：由中关村产业技术联盟联合会承办的北京市科协“益企创新行”走进合成生物制造转化加速中心科普活动

6月10日，由中关村产业技术联盟联合会承办的北京市科协“益企创新行”走进合成生物制造转化加速中心科普活动举办，30余名企业、高校科技从业者与学生参与。活动中，中科院专家介绍合成生物学、胶原蛋白研发等方向成果；中心负责人讲解昌平合成生物产业布局与高通量筛选、质谱检测、医用生物材料三大公共平台。参访人员实地观摩自动化菌株筛选实验室设备，技术负责人分享平台开放共享模式与在药物研发、微生物改造等领域应用，参会代表围绕技术合作开展交流。

活动三：由中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟主办的宽禁带半导体大讲堂——SiC 如何定义下一代固态变压器（SST）

6 月 11 日，由中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟等单位联合主办的宽禁带半导体大讲堂——SiC 如何定义下一代固态变压器（SST）线下直播活动成功举办。活动聚焦 SiC 赋能下一代固态变压器（SST），线上线下累计超 2.3 万人次观看。活动上四名校企、产业专家分别分享 SiC 应用关键技术、高频设备绝缘可靠性、数据中心仿真方案及高压功率半导体市场前景。圆桌环节，专家围绕高频变压器绝缘标准、高低压 SiC 器件技术路线、AI 数据中心 SiC 市场规模等行业痛点答疑交流，分析当前技术瓶颈与两条主流技术路线的优劣势，预判数据中心 SiC 市场具备数十亿美元发展空间。

活动四：由中关村产业技术联盟联合会承办的企创智享云直播课

6 月 12 日，由中关村产业技术联盟联合会承办 2026 “企创智享云”首场直播开课——弘扬科学家精神 聚力抢占未来产业新赛道，线上超 50 万人次观看。同方股份沈仲军作专题分享，梳理科学家精神百年脉络，剖析科研浮躁、核心技术受限等行业问题，结合量子、脑机接口、具身智能等未来产业案例，分析赛道机遇与发展挑战，并依托科学家精神提出应对路径。直播依托多平台同步播出，广泛传播科学家精神。

【时事热点】

正式启动！人形机器人与具身智能实景实训专项行动

6月8日，工信部、国资委联合发文启动2026人形机器人与具身智能实景实训专项行动。行动围绕工业、服务、特种行业，部署六大重点任务，打造实训空间、组建创新联合体、攻坚实操技能、开展实景验证、完善要素保障、总结落地经验，搭建“实训—数据—迭代—规模化”产业闭环。专项覆盖制造、仓储、医疗康养、应急救援等多类场景，依托AI先导区建设实训载体、通用智能模型、实景数据集与高性能整机。目标至2026年底，完成多款产品场景落地常态化应用，形成超百个优质应用场景，实现万台级产品规模化部署，推动人形机器人进入规模化作业阶段，助力产业高质量发展。（中关村融智特种机器人产业联盟）

【行业发展】

落地亦庄！北京首家词元（Token）工厂正式投用

6月9日，北京首家词元（Token）工厂——北京壹号词元工厂在亦庄正式投用，实现算力像电力一样普惠供给，助力北京人工智能之城建设。工厂以服务器集群生产AI基础词元，一期日产能达1.4万亿词元，7×24小时稳定运行，多数任务10秒内响应，适配对话、科研、视频生成等各类AI场景。项目同步发布国内首个开源词元性能基准，统一算力评测标准，规范行业发展。依托亦庄AI产业集聚优势，工厂远期目标日产10万亿词元，还将联动绿电基地搭建京津冀算力集群。该项目补齐规模化算力供给短板，完善区域AI产业链，降低企业使用算力成本。（中关村产业技术联盟联合会）

国产3D DRAM新突破！微电子所实现4层堆叠IGZO存储

6月18日，中国科学院微电子研究所与北京超弦存储器研究院组成的联合研究团队宣布，成功研发出一种可显著提升存储性能与密度的新型3D DRAM（三维动态随机存取存储器）。团队创新性地提出了基于氧化铟镓锌半导体（IGZO）晶体管的“2T0C”单元架构（两个晶体管、零电容器）的单步多层三维堆叠方案，并首次展示了4层堆叠。打破了此前2T0C DRAM技术局限于平面或垂直4F2架构（F2为最小特征面积）的限制，为实现超高存储密度开辟了新路径。该成果已入选2026年IEEE超大规模集成电路技术与电路研讨会，标志着我国在高端存储技术前沿领域取得了关键性进展。（中关村高性能芯片互联技术联盟）

北京RISC-V数字基础设施创新中心揭牌成立

6月18日，经北京市经信局批复，北京 RISC-V 数字基础设施创新中心正式设立。该中心由奕斯伟计算、RDI 聚力联盟、亦庄智能城市研究院等单位牵头组建，中电标协 RISC-V 工委、北京开源芯片研究院协同共建。中心将搭建“1 基地+5 平台”支撑体系，打造生态聚合、适配开发、测试验证、应用示范、标准规范五大平台，整合上下游产业链资源，面向智算中心、智能交通、金融、政务等领域输出标准化 RISC-V 落地方案。未来中心将推动 RISC-V 技术从单点研发转向全场景集成落地，补齐国产 RISC-V 软硬件生态短板，助力北京打造具备全球竞争力的开源芯片产业创新高地。（中关村高性能芯片互联技术联盟、北京长风信息技术产业联盟）

政校协同育工匠！共建亦城产业工人实训中心

6月18日，北京经开区总工会与北京科技职业大学签约共建亦城产业工人实训中心。该合作是区域深化产教融合、推进政校协同的重要举措，契合“十五五”培育新质生产力的发展需求，构建起“工会主导、高校施教、企业出题、职工受益”全新协同育人模式。北京科技职业大学将实训中心作为服务区域产业升级的重点工程，整合优质资源保障运营落地。中心结合经开区产业特色定制培训课程，开展标准化专业培训，提升产业工人专业技能。双方完善联动机制，致力于将实训中心打造为经开区产业工人培育核心阵地、首都产教融合示范标杆与校地协同育人样板平台。（北京长风信息技术产业联盟）

【企业动态】

企业近期融资情况

6月8日，北京安纳智芯科技有限公司完成Pre-A轮融资。本轮融资由中赢创投、峰瑞资本、经纬创投、讯飞创投、阿尔法公社等知名投资机构联合投资，具体融资金额未披露。（北京长风信息技术产业联盟）

6月9日，北京绿色康成生物技术有限公司完成数千万元Pre-A轮融资。本轮融资由北京国管旗下的北京市绿色能源和低碳产业投资基金，以及北京未来星科创业投资中心和北京昌建发投资管理中心联合重磅加持。（北京长风信息技术产业联盟）

6月9日，北京百奥几何生物科技有限公司完成新一轮数亿元战略融资。本轮融资由上海生物医药创新转化基金、国科投资、达晨财智、星连资本联合领投，高榕资本、指数人工智能产业创新基金跟投，指数资本担任独家财务顾问。（北京长风信息技术产业联盟）

6月9日，北京玩点旅行有限公司完成超1亿元人民币Pre-A轮融资。本轮融资由敦鸿资产领投，财通资本、头头是道、源铄资本跟投，同时DeepSeek部分股东同步加码增持。（北京长风信息技术产业联盟）

6月10日，北京千诀科技有限公司完成数亿元A轮融资，本轮由京铭资本领投，山东新动能、山东财金资本、元禾厚望、芯能创投、南创投、英诺天使基金、尚势资本、仁爱集团、玄素投资等机构共同投资，投资方阵容汇集了国家队、产业方、市场化基金及家族办公室。（北京长风信息技术产业联盟）

6月15日，北京极佳视界科技有限公司再获10亿元B2轮融资，本轮融资由新加坡顶级跨境投资机构狮城资本、中国一比利时基金（中比基金）、建投投资、万向钱潮、复星锐正、华盖创赢、金创投、德屹资本、华仓资本、元石基金等全球顶级国家队基金、产业资本、财务机构、国资平台共同投资，国中资本、达晨财智、图灵资管等多个老股东持续超额加注。（北京长风信息技术产业联盟）

6月16日，北京深朴智能科技有限公司完成数亿元Pre-A轮融资。本轮融资由滴滴领投，梅花创投、柯力传感跟投，老股东创世伙伴创投、线性资本、普华资本持续加码。（北京长风信息技术产业联盟）

6月16日，北京硅基流动科技股份有限公司完成超20亿元B轮融资，华兴资本担任独家财务顾问。本轮投资方覆盖能源、国产芯片、算力、云服务、大模型、产业应用全产业链头部资本、国资与产业集团。（中关村高性能芯片互联技术联盟、北京长风信息技术产业联盟）

6月16日，相干（北京）科技完成数亿元Pre-A+轮融资，本轮由北京市量子基金领投。（中关村高性能芯片互联技术联盟）

6月17日，北京捷象灵越科技有限公司完成A+轮投资，投资方为极智嘉。（北京长风信息技术产业联盟）

6月17日，北京分子之心科技有限公司获得A轮融资，累计融资金额逾1亿美元。本轮融资由蓝桥资本、浦东创投、中粮新兴产业基金、东方富海、复星创富、国方创投、赛分科技、英飞尼迪、财鑫资本、正鼎等机构参与投资，凯赛生物、芯航资本等

老股东继续追加投资。（北京长风信息技术产业联盟）

6月17日，章鱼动力（北京）科技有限公司（SynapX）完成5000万美元新一轮融资。本轮由锦秋基金、芯联资本、黄浦江资本领投，多家海内外机构参与，线性资本等老股东持续加码。（中关村高性能芯片互联技术联盟）

6月17日消息，北京逆矩阵科技有限公司（Physis）完成超亿美元种子++轮融资。本轮融资由经纬创投、光合创投、五源资本、BAI资本、钟鼎资本联合投资，蚂蚁集团战略入局，高瓴创投、北大燕缘创投等老股东持续加码，高鹄资本担任独家财务顾问。

（中关村高性能芯片互联技术联盟）

全国首款龙架构农业专用 SoC “农芯一号” 流片成功

6月12日，龙芯中科联合江苏大学研发的全国首款基于龙架构的农业专用 SoC 芯片“农芯一号”顺利完成流片，这也是龙芯“百芯计划”的又一重要落地成果。该芯片拥有耐高温、耐腐蚀、抗冲击等特性，兼具多接口适配、数据处理高效、运行稳定等优势，可广泛应用于精准农业、智慧温室、智能农机等场景，有效解决了智慧农业领域芯片依赖进口、环境适配能力弱、接口不兼容等难题，保障农业设备在复杂工况下稳定运转。（中关村高性能芯片互联技术联盟）

经开区国科天迅自研芯片护航火箭箭载通信

6月17日，北京国科天迅科技股份有限公司的提供箭载骨干通信总线系统解决方案，保障中国长征十二号运载火箭成功完成第6次发射任务成功，将22组低轨卫星精准送入轨道。该方案的核心是由该公司自主研发的FC-AE-1553协议芯片。该芯片是一款

全自主可控、全国产化的单片数字集成电路，已规模化量产，在多类国家重点型号任务中经受过检验。同时，该芯片支持网络控制器、网络终端和网络监控器三种角色，适配总线式与交换式网络拓扑，并兼容主流国产操作系统，可充分满足运载火箭对高可靠、低时延、高同步箭载网络传输的严苛需求。（中关村高性能芯片互联技术联盟）

首款 3D 混合堆叠大模型专用处理器落地

6 月 17 日，算苗科技(北京)有限公司官宣，面向大模型推理场景自研的 3D TokenPU 芯片 A4E 已于 6 月 15 日完成流片，国内首款依托完整国产供应链打造的 3D 混合堆叠大模型专用处理器落地。针对大模型推理普遍存在的内存、算力、通信三重瓶颈，A4E 首创 3D TokenPU 原生推理架构，将 8 层存储晶圆垂直堆叠于计算晶圆，微米级互联带来 16TB/s 超高访存带宽，大幅降低数据搬运能耗与成本。芯片采用 Tile-Native 软硬件协同设计，兼容主流开源编译工具链，有效降低推理总拥有成本。该芯片基于自研 RISC-V 架构、自研 IP 与软件体系打造，全流程配套国内供应链，团队具备万片级 3D 堆叠晶圆量产成熟经验。（中关村高性能芯片互联技术联盟）